

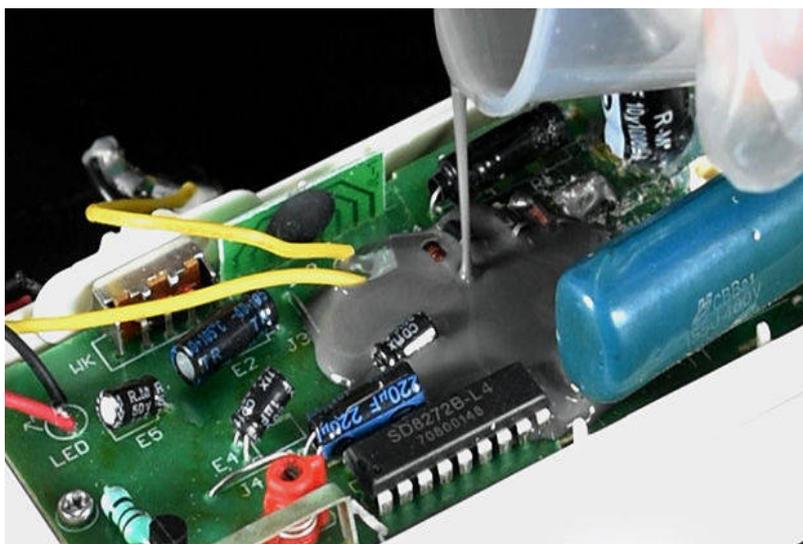
双组分有机硅灌封胶 SC2030

产品概述：

SC2030 是一款灰色含填料的双组份有机硅灌封材料，具有导热和低成本的特点。有机硅基材本身耐高低温，可长期稳定工作在高温环境中。双组分灌封胶固化无需高温或特殊设备，常温或中温固化即可，节省能耗。相比高导热环氧树脂或聚氨酯材料，有机硅在综合性能与成本间取得较好平衡。

产品应用：

传感器、变压器、汽车电子（如 HID 灯模块）的防潮密封。



固化物技术参数：

测试项目	测试标准	单位	典型值
外观		—	灰色
物理性状	-	—	流体
操作时间	-	min	30
密度	ASTM D792	g/cm ³	1.5
粘度	ISO 2555	cps	4000
硬度	ISO 868	Shore A	60
导热率	ISO 8301	W/m · K	0.70
耐温范围	ISO 11357	°C	-55~240

可根据客户需求进行定制。

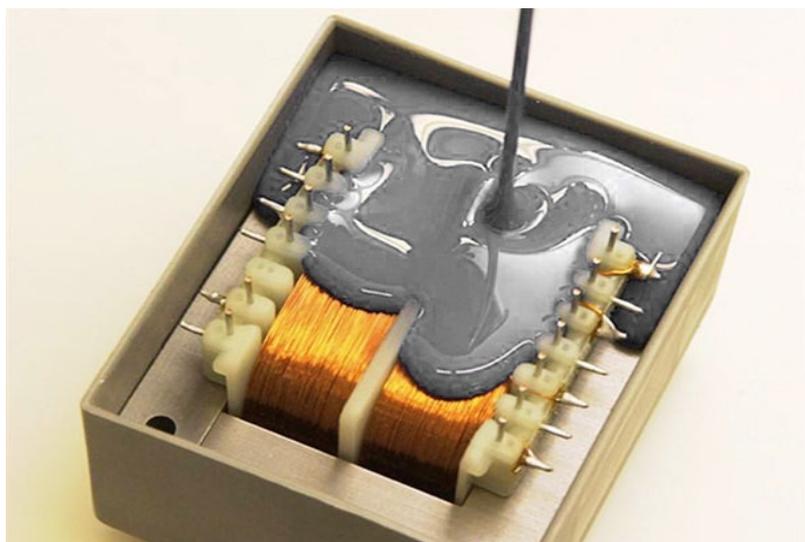
双组分有机硅灌封胶 SC2130

产品概述：

SC2130 是一款灰色含填料的双组份有机硅灌封材料，具有导热和低密度的特点。减轻设备整体重量，适用于对重量敏感领域（如航空航天、新能源汽车、便携式电子设备）。低密度胶体黏度更低，易于填充复杂结构或微小缝隙，减少灌封气泡。

产品应用：

新能源汽车、消费电子以及航空航天等电子器件



固化物技术参数：

测试项目	测试标准	单位	典型值
外观		—	灰色
物理性状	-	—	流体
操作时间	-	min	30
密度	ASTM D792	g/cm ³	1.66
粘度	ISO 2555	cps	4000
硬度	ISO 868	Shore A	40
导热率	ISO 8301	W/m.K	1.00
耐温范围	ISO 11357	°C	-55~240

可根据客户需求进行定制。

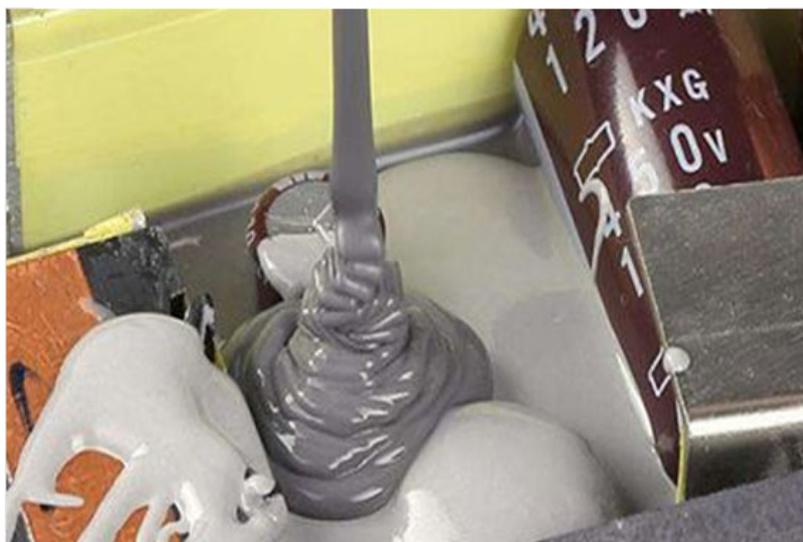
双组分有机硅灌封胶 SC2230

产品概述：

SC2230 是一款灰色含填料的双组份有机硅灌封材料，具有高导热的优异性能。能与金属或陶瓷界面贴合紧密，减少接触热阻，提升整体散热效率，避免元器件因过热降频或失效。固化后体积稳定，减少热循环（冷热交替）导致的应力开裂或界面剥离。

产品应用：

新能源汽车、消费电子以及航空航天等电子器件



固化物技术参数：

测试项目	测试标准	单位	典型值
外观		—	灰色
物理性状	-	—	流体
操作时间	-	min	30
密度	ASTM D792	g/cm ³	2.80
粘度	ISO 2555	cps	10000
硬度	ISO 868	Shore A	50
导热率	ISO 8301	W/m · K	2.00
耐温范围	ISO 11357	℃	-55~240

可根据客户需求进行定制。